



深圳长城开发科技股份有限公司

**2019 年半年度报告摘要**

**2019 年 08 月**

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编号：2019-028

## 深圳长城开发科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谢韩珠	独立董事	个人原因	邱大梁

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	深科技	股票代码	000021
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李丽杰	唐磊	
办公地址	深圳市福田区彩田路 7006 号	深圳市福田区彩田路 7006 号	
电话	0755-83200095	0755-83200095	
电子信箱	stock@kaifa.cn	stock@kaifa.cn	

## 2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,466,509,240.29	8,264,991,735.06	-21.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	149,620,968.94	171,778,212.80	-12.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,760,110.76	24,505,156.22	123.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	262,323,739.07	140,360,575.28	86.89%
基本每股收益（元/股）	0.1017	0.1168	-12.93%
稀释每股收益（元/股）	0.1017	0.1168	-12.93%
加权平均净资产收益率	2.35%	2.89%	-0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,094,334,024.31	15,539,378,939.58	-2.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,300,410,415.72	6,285,956,609.93	0.23%

## 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	115,606	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
					股份状 态	数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	44.51%	654,839,851			
博旭（香港）有限公司	境外法人	7.25%	106,649,381			
柴长茂	境内自然人	1.08%	15,882,618			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	8,825,598			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	3,993,100			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.26%	3,799,460			
张靖	境内自然人	0.23%	3,315,000			
周淑芳	境内自然人	0.21%	3,092,700			
龙力控股有限公司	境外法人	0.18%	2,598,900			
张榕硕	境内自然人	0.18%	2,580,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二天股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 15,882,618 股。					

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019上半年，面对错综复杂的国内外政治经济环境，公司经营班子坚定执行董事会战略部署，聚焦产品力提升，始终坚持稳中求进的发展思路，大力开拓国内外市场，稳步推进产业结构调整。作为全球领先的电子产品制造服务（EMS）专业提供商，深科技在现有EMS核心业务基础上，积极寻求新兴产业成长机会，加大力度布局集成电路半导体封装与测试和新能源汽车电子等战略性新兴产业。一方面通过推进智能制造持续优化先进制造管理体系，夯实公司EMS核心能力，并在保持现有EMS核心产品制造服务优势的同时，着力提高管理和运营效率，持续提升企业发展质量和效益，另一方面通过自主创新等方式，促进产业结构调整，实现业务的可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入64.67亿元，同比下降21.76%，主要是由于受国际局势影响，内存条业务量下降所致；实现归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比下降12.90%，但主营业务利润同比增长44.40%。

### 1) 集成电路相关产品

公司作为目前国内唯一具有从集成电路高端 DRAM / Flash 晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业，持续发展先进封装测试技术，积极参与委外封装测试项目，力求在新一轮产业变革中构筑先发优势。

报告期内，公司深耕行业及贴近客户需求，在业务拓展方面取得新的突破，其中委外封测项目稳步推进，并与行业龙头存储企业开展业务合作。目前公司芯片封测产品主要包括 DDR3、DDR4，LPDDR3、LPDDR4、eMCP、USB、eMMC、ePOP、SSD、3D NAND 以及 Fingerprint 指纹芯片等，并具备 wBGA、FBGA、LGA 等封测技术。面对国内外存储芯片向高速、低功耗、大容量发展的趋势，公司的主营产品也由 DDR3、LPDDR3、64L 3D NAND 逐步向 DDR4、LPDDR4、96L 3D NAND 升级，公司已着手研发倒装芯片技术和隐形预切割超薄研磨（SDBG）技术，同时继续推动 DDR5、GDDR5 等新产品的应用，并致力于发展研发晶圆级封装、系统级封装、硅穿孔等先进封装技术，紧跟行业趋势和客户需求，不断增强公司产品的核心竞争力。

报告期内，LED 芯片制造行业景气度下降，行业处于竞争洗牌中，公司 LED 点测分选业务亦受到一定程度的影响。未来随着 Mini-LED 以及 Micro-LED 应用规模的扩大，LED 芯片供需关系将大为改善。公司持续对 Mini-LED 倒装芯片封测技术开展研发工作，在背光源模组制造方面已储备一定技术基础。

在存储产品领域，产品主要包括内存模组、USB 存储盘（U 盘）、Flash 存储卡、SSD 等存储产品，公司采用行业领先的生产制造工艺，为客户提供包括 SMT 制造、测试、组装、包装及全球分销服务，提供存储集成电路设计、制造、封测的配套业务。报告期内，受国际局势影响，公司存储产品营业收入同比下降，并由此导致公司整体营业收入的下滑，但由于公司加强内部管控以及产品结构调整等，公司存储产品主营业务利润同比略有增长。

### 2) 自主研发产品

公司自主研发产品主要包括计量系统产品、自动化设备产品、工业物联网产品等业务。

在计量系统业务领域，公司主营智能水、电、气等能源计量管理系统的全套解决方案及配套产品和服务，拥有 20 多年研发、营销及先进制造的丰富经验，业务已遍布欧洲、南美、亚洲、非洲等地，报告期内，公司新开拓了巴西等国家客户。经过多年的发展，公司已在英

国、荷兰、韩国、泰国、成都、香港等地设立了分支机构，与多个地区国家级能源事业单位客户建立了合作关系。报告期内，公司经营业务发展迅猛，营业收入同比增长 45.03%，公司推出的 NB IoT（窄带物联网）应用模组，应用于电、水、气、热表的物联网改造，已在意大利完成 NB-IoT 水表项目试点。未来公司将继续提高技术研发实力，为市场提供更专业、更经济的智能用电产品及系统解决方案。

在自动化设备领域，公司已形成高精密自动装配、自动点胶、自动贴标、自动化线体以及非标自动化五个产品系列。报告期内，在满足公司内部需求的同时，积极开拓外部市场，不断加强在自动化产品领域的技术创新和资源整合，为客户提供智能高效的自动化生产线及自动化解决方案。

在工业物联网领域，公司设有专业团队专注于物联网产品的研发和应用，拥有实时静电防护监控系统（KEDAS）、工业物联网系统（iDAS）智能工地管理系统（iFOS）、智能离子风机等多项自主研发的工业物联网专利和产品。公司在已有技术基础上，重点研制开发工业物联网核心软硬件产品及平台技术，成功开发出工业物联网云平台，并通过物联网在管理和生产中的应用，进一步提高了各类智能产品的质量和可靠性，生产管理效率不断提高。报告期内，公司智慧工地产品线与中设集团达成战略合作，双方将在研发安全监管和智慧管理产品的基础上，通过物联网技术实现多层次管理，打造建设行业与信息产业合作的新平台。

### 3) 硬盘相关产品

公司硬盘相关产品包括硬盘磁头、硬盘电路板和盘基片。

个人电脑需求逐年下滑，固态硬盘市场份额的持续扩大致使传统硬盘市场出货量继续萎缩，受其影响，报告期内公司的硬盘磁头及相关产品业务均有不同程度的下降。但在数据安全和容量需求领域，仍带动了一定的传统硬盘需求。公司将不断调整产品结构，持续加强工艺的改进与研发，引入存储服务器、固态硬盘等新业务的生产，延伸业务产业链。

### 4) 电子产品制造服务

电子产品制造业务是指公司为客户提供物料采购、SMT 贴片、整机组装、测试、物流配送等环节的电子产品制造服务，主要包括通讯与消费电子、医疗产品、商业与工业等业务。

在通讯与消费电子领域，为促进通讯业务的可持续健康发展，提高产品综合竞争力，公司在桂林设立的子公司已于 2019 年 8 月正式投产，厂房全部建成后所形成产能可为公司带来更多的增量业务。报告期内随着客户市场占有率的不断提升，公司手机业务订单量实现稳定增长。目前公司已导入通信基站板卡业务，该业务工艺复杂利润可期，有望成为公司新的利润增长点。

在医疗产品业务领域，公司拥有通过广东省医疗器械质量监督检验所检测的无菌净化生产车间，具备医疗产品联合设计和制造能力，目前产品包括呼吸机、腹膜透析加温仪、智能血糖仪等。未来公司通过不断扩大医疗器械研发团队，加大“家用医疗产品”、“便携式医疗器械”及“慢病管理类医疗器械”的研发投入，持续对现有产品进行升级，以提升公司在该领域内的市场份额和行业影响力。

在其他电子产品方面，报告期内，公司机器人业务开展顺利，在原先开拓客户基础上成功开拓国内行业领先扫地机器人客户，目前已导入两条组装体线。消费级无人机业务与行业领先的无人机厂商合作多年，长期稳定的品质获得客户高度认可，公司凭借多年电子行业制造经验，有望与行业知名客户开展进一步深入合作，为未来发展打开业务成长空间。

### 5) 新能源业务

在动力电池领域，公司与全球知名的汽车动力电池系统企业建立合作关系，目前已有数款产品进入试产阶段，预计 2019 年第四季度开始量产，未来有望在新能源汽车电子方面通过发挥产业链优势，共同做大做强新能源汽车业务。

在超级电容领域，公司与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系，目前主要客户为 MAXWELL 和 TECATE，导入的两条单体制造生产线已开始规模量产。公司未来将积极布局超级电容相关技术工艺的提升和产业化，为公司在该领域的快速发展奠定基础。

### 6) 产业基地概况

报告期内，公司持续推进海外走出去战略，在全球产业链核心地区进行产业布局，贴近大客户配套生产，在马来西亚、菲律宾等国家设有产业基地，在日本设有研发基地，在美国设有新产品导入基地。目前公司已建有深圳、苏州、东莞、惠州、成都、马来西亚、菲律宾等产业基地。其中重庆智能制造基地占地约 700 亩，项目规划建设主要为电子产品的研发、生产和销售。桂林智能制造基地占地约 700 亩，导入通讯和消费电子等智能制造服务业务，已于 8 月 16 日正式投产。成都智能制造产业基地启动建设，未来可进一步满足公司计量系统产品研发制造业务快速增长所带来的产能需求。公司国内外产业基地的战略布局，为进一步开拓国内外市场奠定了坚实基础。

报告期内，深科技城已完成招商前期调研工作，未来将建成以“科技、研发、金融、专业服务”为核心产业聚集的城市创新综合体，一期项目工程进展顺利，地下室土方总量已完成过半。深科技城项目在满足自用的前提下将以出租为主，届时将为公司带来更为充沛的现金流。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具系列准则相关规定，公司关于金融工具的会计处理按照财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定执行。有关情况请参阅公司 2019 年 4 月 20 日发布的相关公告（2019-016）。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳长城开发科技股份有限公司  
董事会  
二零一九年八月三十一日